МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ГРАДИЕНТОВ В СВЧ ПЛАТЕ МАКЕТА АВТОМОБИЛЬНОГО РАДАРА

Журавлёв В. И., Наумович Н. М., Стежко И. К.

Центр 1.6, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники Минск, Республика Беларусь E-mail: vadzh@bsuir.by

Рассмотрено построение тепловой модели для оценки распределения температуры в печатных модулях автомобильных радарах. Результаты моделирования показывают возникновение значительных градиентов температуры, влияющих на выходные параметры.

Введение

Использование компактных фазированных решёток миллиметровых волн быстро развивается в таких областях как автомобильные радары, спутниковая и транзитная связь, сканирование систем безопасности и формирование изображений. Технология «антенна в корпусе» (AiP) стала основным вариантом интегрированного корпуса с антенной и приёмопередатчиком для применения в автомобильных радарах на частоте от 72 ГГц [1]. При её использовании может быть достигнуто значительное уменьшение габаритных размеров, и уменьшение потерь и повышение эффективности передатчика. Однако для применения в диапазоне миллиметровых волн требует применения дополнительных мер по отводу тепла. Это обусловлено возникновением градиентов температуры в ограниченным пространстве вследствие использования многослойной компоновки печатных плат с теплонагруженными компонентами и технологии AiP. Анализ тепловых характеристик позволяет оптимизировать конструкцию корпуса и систему охлаждения.

I. Тепловая модель многослойной структуры

Поскольку технология AiP на одной плате с приёмопередатчиком представляет собой неоднородную структуру, включающую компоненты с разными тепловыми свойствами. Задача представляет собой процесс распространения теплоты в анизотропном теле, содержащим некоторое количество слоёв. Имеется некоторая сложность получения аналитического решения для многослойной структуры и громоздкости применяемого математического аппарата, поэтому требуется применить некоторые допущения.

В используемых на практике моделях полагается, что слои, сформированные в объёме кристалла, имеют одинаковые теплофизические параметры и различаются только по электрическим характеристикам. Ряд моделей позволяет определить закон теплопереноса в структурах со строго ограниченным количеством слоёв, другие модели рассматривают только процесс постоянного нагрева [2]. В рассматриваемом случае достаточно

определить закон распространения избыточной температуры T в заданном слое структуры при воздействии импульсного теплового источника.

Рассмотрим модель многослойной структуры, на поверхности которой действует импульсный источник тепла P_0 (рис. 1). Каждый слой однороден, но имеет собственное постоянное значение теплопроводности K.

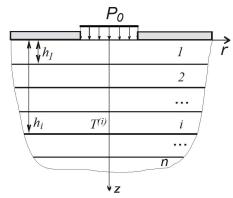


Рис. 1 — Модель многослойной структуры с импульсным источником тепла на поверхности

Двумерное уравнение теплопереноса в структуре можно записать в виде:

$$K_{11} \frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + 2K_{12} \frac{\partial^2 T}{\partial r \partial z} + K_{22} \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} = 0$$
 (1)

Выражение (1) представляет собой линейное дифференциальное уравнение с постоянными коэффициентами. Для i-слоя структуры можно выполнить линейное преобразование координат [3]:

$$\begin{bmatrix} R \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a_i \\ 0 & b_i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r \\ z \end{bmatrix} + \sum_{k=1}^{i-1} h_i \begin{bmatrix} a_i & -a_{i+1} \\ b_i & -b_{i+1} \end{bmatrix}$$
(2)

где

$$a_i = -\frac{K_{12}^{(i)}}{K_{22}^{(i)}}, \ b_i = \frac{K_i}{K_{22}^i}, \ K_i = \sqrt{K_{11}^{(i)} K_{22}^{(i)} - K_{12}^{(i)^2}}$$

Физический смысл (2) заключается в том, что задача анизотропного теплопереноса представляется эквивалентной задачей изотропного

теплопереноса. Преобразование через (2) является линейным и непрерывным, а также не имеет деформации граничных условий на рассматриваемом участке структуры.

Соответственно,

$$K_{i+1}(\frac{\partial^{2} T^{(i+1)}}{\partial R^{2}} + \frac{\partial^{2} T^{(i+1)}}{\partial Z^{2}}) + K_{1}(\frac{\partial^{2} T^{(1)}}{\partial R^{2}} + \frac{\partial^{2} T^{(1)}}{\partial Z^{2}}) = 0$$
(3)

Уравнение (3) при заданных граничных условиях можно аналитически решать поэтапно двунаправленными преобразованиями Фурье [4]. Использование численных методов позволяет значительно сократить затраты на поиск решения для произвольного слоя.

II. Моделирование градиента в теплоотводящем слое

Моделирование распределение температур в AiP плате макета автомобильного радара (рисунок 2) выполнялось с применением численного метода конечных элементов с открытыми граничными условиями второго рода для нормальных условий эксплуатации при температуре окружающей среды (воздух) 35 °C [5]. Однотипные материалы заменялись аналогичными, но с отличающимися нетепловыми свойствами во избежание пропуска границ тепловых сопротивлений при однородной сетке.

Результаты моделирования для платы приёмопередающего модуля (СВЧ) наиболее важны, так как возникновение больших перепадов температуры в ней наиболее критично. Вид её полученного теплового профиля в составе корпуса приведён на рисунке 3 (корпус не показан).

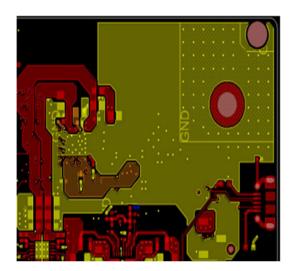


Рис. 2 – Теплоотвод металлизацией на нижней стороне платы СВЧ

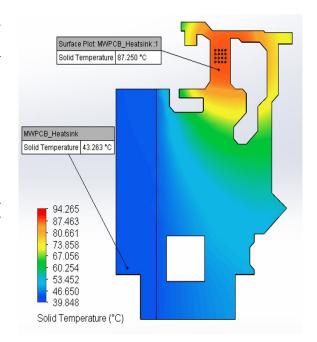


Рис. 3 — Расчётное распределение температуры по теплоотводящему слою

III. Заключение

Моделирование теплового профиля в многослойных структурах автомобильных радаров указывает на возникновение довольно больших градиентов температур. Это следует учитывать в дальнейшем при возможном проектировании дополнительного теплоотвода, так как может привести возникновению к термомеханическим напряжениям и ухудшить параметры передающей антенны.

Список литературы

- Han, Y. AiP component and board level heat dissipation analysis for automotive radar /Y. Han, T.C. Chai and S.S. H. Lim // 2021 IEEE 71st Electronic Components and Technology Conference (ECTC). – 2021. – P.1850–1857.
- D'Alessandro, V. A critical review of thermal models for electro-thermal simulation / V. d'Alessandro, N. Rinaldi // Solid-State Electronics. - 2002. - №46. - P.487-496.
- Ma, C.C. Analytical exact solutions of heat conduction problems for anisotropic multi-layered media / C.C. Ma, S.W. Chang // International J. of Heat and Mass Transfer. – 2004. – №47. – P.1643 –1655.
- Dwyer, V.M. Thermal failure in semiconductor devices. / V.M. Dwyer, A.J. Franklin, D.S. Campbell // Solid-State Electronics. – 1990. – Vol.33, №5. – P. 553–560.
- Журавлёв, В.И. Моделирование теплового режима образца автомобильного радара / В.И. Журавлёв, Н.М. Наумович, С.А. Кореневский // «Приборостроение-2022»: материалы 15-й Международной научно-технической конференции, Минск: БНТУ, 2022. С.253-254.